



# イノベーションに 磨きをかける。

イノベーションに磨きをかける。

最先端を研ぎ澄ます。

次の100年を切り開き、世界の常識を塗り替える。

日本には「つゆはらい」という言葉があります。

行列の先を行って障害を取り払うこと。

人々を先導すること。

転じて、何かを最初に行うこと。

お客様が進む未来の先に立ち塞がる課題を、先回りして取り除いておく。

世の中に横たわる課題に、まだ来ない誰かが躓かないように解決しておく。

100年にわたり「塗る・切る・磨く」ソリューションを提供してきた

私たちの仕事は、お客様と社会の行く先に磨きをかけること。

そして皆さんと切磋琢磨しながら、

私たち自身の技術にも磨きをかけることに他なりません。

これからの100年も、

未来が、眩しく光輝くように

私たちは、強く優しく磨き続けます。



商号変更及びコーポレートロゴ刷新

# Mipox 株式会社はマイボックス株式会社へ。

旧ロゴ・商号

mipox

Mipox株式会社

新ロゴ・商号

◀MiPOX▶

マイボックス株式会社

当社は2025年11月21日に創業100周年を迎えました。



これまでの歩みと実績をさらに発展させるべく、2025年10月1日にコーポレートロゴを刷新するとともに、従来の「Mipox株式会社」から、より発音しやすく親しみやすい「マイボックス株式会社」へと商号を変更いたしました。

新ロゴコンセプト「はみ出すことで見える価値」



当社は創業以来 100 年にわたり、既存の概念にとらわれない姿勢で、常に革新を追求してまいりました。新ロゴは、はみ出すことで新たな価値を発見する当社の挑戦的かつ責任ある姿勢を視覚的に示し、絶え間ないイノベーションへの取り組みを象徴しています。

## 変わることを忘れない 『100年ベンチャー』

当社は1925年にドイツ・レイボルト商館の子会社として創業し、輸入した顔料を販売する傍ら主に出版物に使われる色箔の製造を生業としておりました。1960年代後半よりこの色箔を製造する中で培った「塗る」技術、それを裁断する「切る」技術を基に、精密部品の製造工程事業に使用される研磨フィルムを開発し、「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術を確立いたしました。

精密研磨材専門メーカーとして発展を経て、2000年初頭からはコア技術である『塗る』をサービスとして提供するエンジニアリングサービス（受託塗布）を開始いたしました。創業来の危機である2008～2010年を乗り越えたあとは、『磨く』をサービスとして提供するウエハープロセス（受託研磨）を立ち上げ、「塗る・切る・磨くで世界を変える」に取り組んでまいりました。2016年には研磨布紙メーカーである日本研紙を仲間に加え、製品事業のラインナップの拡充を進めました。

創業から間もなく100年。事業を長く続けていくために、急速に変化するテクノロジーや世の中の価値観を敏感にとらえながら、自らも変化に順応していくことが求められます。こうした時代のニーズに対応するため、わたしたちが培ってきたコア技術をさらに高めながら、新しい事業にも積極的にチャレンジし、世の中に必要とされる製品やサービスを通じて世界のお客様に選ばれるパートナーを目指してまいります。

変わることを忘れない、『100年ベンチャー』を目指してこれからも変化し続ける集団でありつづけます。

今後とも皆様のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 渡邊 淳



# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

会 社 名	マイボックス株式会社
英 文 名	Mipox Corporation
創 業	大正14年（1925）年11月21日
設 立	昭和16年（1941）年12月12日
代 表 者	代表取締役社長 渡邊 淳
本店・本社	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18
株式市場名	東京証券取引所 スタンダード
証券コード	5381

## 【経営方針】

### 付加価値向上

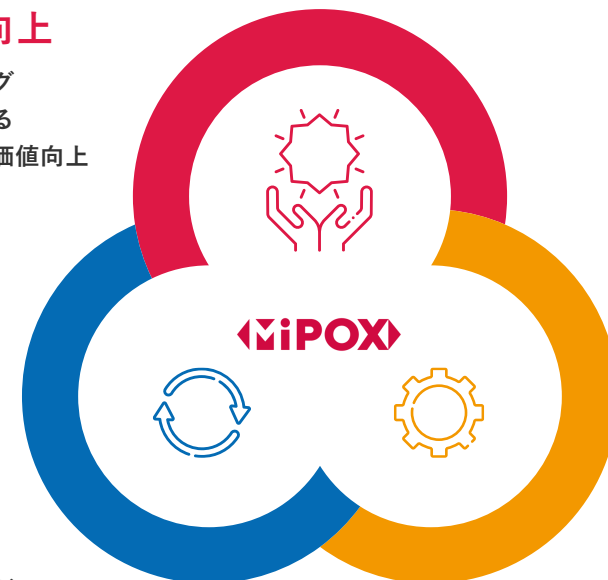
エンジニアリング  
アプローチによる  
製品事業の付加価値向上

### 事業転換

受託事業から  
エンジニアリング  
サービス事業への転換

### 経営基盤の整備

早い変化と  
多様性に対応できる  
経営基盤の整備



## 「塗る、切る、磨く」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業です。  
コア技術を組み合わせ、お客様の成功のための付加価値を創造するための製品とサービスを提供します。



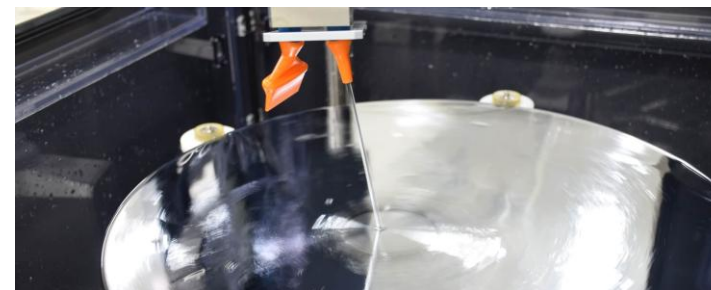
### 塗る Coating

PETフィルム、銅箔、織布、紙等の基材に、調合した樹脂等の塗料を均一に塗布。  
自社製品である研磨材や反射材だけでなく、保有する複数の塗工機によって要望に合わせた機能性フィルムの製造も実現。



### 切る Slitting

「塗る」ことで出来た製品を希望のサイズに裁断（スリット）。高精密さが求められるハードディスク向け研磨フィルムの製造で培った技術によって、裁断が困難といわれている素材でも精度の高い切り口と巻き上げを実現し、高品質の製品を提供。



### 磨く Polishing

徹底的な顧客視点を持った製品開発のために自社の研磨材と独自の研磨装置で研磨プロセスの研究を積み重ねる。  
ハイテク分野で培った高精度研磨加工技術で次世代半導体ウェーハの研磨にも挑戦し、研磨市場に於けるプロフェッショナルを目指す。



拠点開設	事業領域	売上高（百万円）	トピックス
1925 東京都京橋区にて設立	製品事業 受託事業		顔料と色箔の輸入業者としてドイツ資本により設立（独逸顔料合名会社）
1981			日本マイクロコーティング㈱へ商号変更
2001		6,858	JASDAQ店頭市場に上場
2002		4,439	
2003		4,949	
2004		7,197	
2005		10,799	
2006		8,966	
2007		8,329	
2008		6,083	
2009		3,238	2009年3月期 渡邊淳が代表取締役社長に就任（現代表）
2010		3,013	受託事業強化
2011		3,157	
2012 インド、中国（上海）		3,045	
2013 フィリピン		2,815 594 3,409	Mipox㈱へ商号変更、本社を東京都立川市へ移転
2014 台湾		3,202 558 3,760	
2015 京都府京都市		3,606 379 3,985	日本レフライト工業㈱を子会社化、Mipox Kyoto㈱を設立
2016 ベトナム、広島県福山市		3,930 274 4,204	日本研紙㈱を子会社化
2017		6,219 190 6,410	Mipox Kyoto㈱を吸収合併
2018		7,009 816 7,826	
2019		7,083 474 7,558	日本研紙㈱の営業機能を統合
2020 中国（深セン）		6,832 506 7,338	Ref Liteのリブランド
2021 広島県呉市		6,416 944 7,361	本店を山梨県北杜市へ移転、日本研紙㈱を吸収合併、オムニ・カーボナイト事業を吸収分割
2022 栃木県鹿沼市		7,570 2,879 10,449	ミスミ化学㈱を子会社化、本社を東京都四谷に移転
2023		7,948 2,080 10,029	本店本社を栃木県鹿沼市へ移転、㈱スガコーディングスの粉体塗装事業を譲受、(有)大久保鉄工所を子会社化
2024 熊本県熊本市、宮城県仙台市、石川県金沢市		7,618 1,735 9,354	インド工場を移転、thomas ㈱への出資
2025		9,956 1,215 11,172	創業100周年、マイボックス株式会社へ商号変更



## 製品事業

研磨材の製造・販売

売上高  
構成比 **89%**

ハイテク  
関連製品 **50%**

HDD関連、半導体、光ファイバー等  
で使用される研磨材の製造・販売

一般研磨  
関連製品 **39%**

自動車、鉄鋼関連等で使用される  
研磨材の製造・販売

ハイテク  
関連製品

半導体関連

光ファイバー  
関連

HDD関連

自動車関連

鉄鋼関連

その他

一般研磨  
関連製品

2025年3月期  
売上高  
**11,172**  
百万円

国内外売上高比率（2025年3月期）

日本44%

海外56%

## 受託事業

顧客から材料の支給を受け  
当社グループが保有する設備で受託加工

売上高  
構成比 **11%**

受託塗布・  
スリット **7%**

顧客からフィルムや塗料材等を預かり、  
当社設備を使用して加工製造

受託研磨  
加工 **4%**

半導体用途を中心にウェーハ等の材料  
を預かり、当社の研磨材と設備を使用  
して研磨加工

受託塗布・  
スリット

受託研磨加工

# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

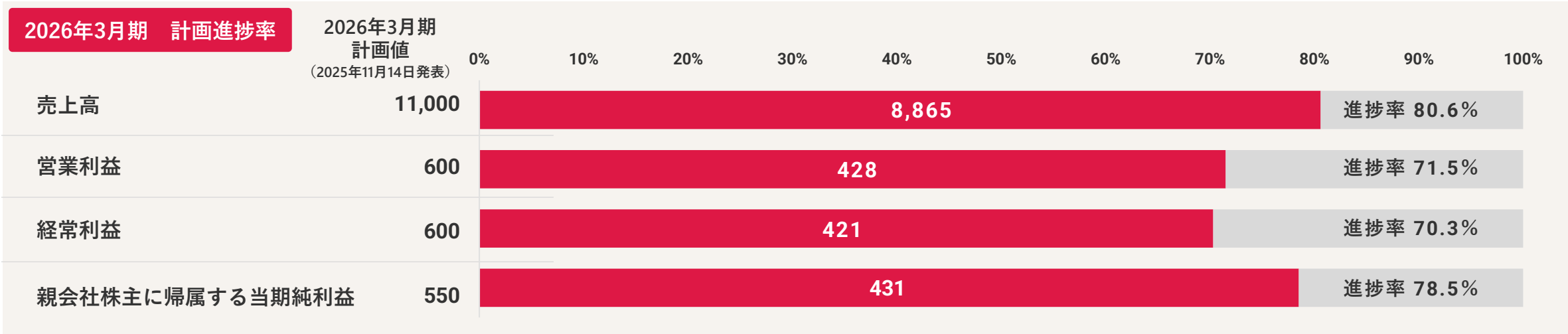
07

Appendix

Appendix

前年同期と比較し売上高は若干増加しましたが、販売費及び一般管理費が大きく増加し、営業利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期を下回りました。

(単位：百万円)	2025/3期 3Q	2026/3期 3Q	前年同期比
売上高	8,306	8,865	6.7%
売上総利益	3,283	3,441	4.8%
販売費及び一般管理費	2,445	3,012	23.2%
営業利益	837	428	▲ 48.8%
為替差損益	▲ 1	▲ 4	-
経常利益	898	421	▲ 53.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	801	431	▲ 46.1%

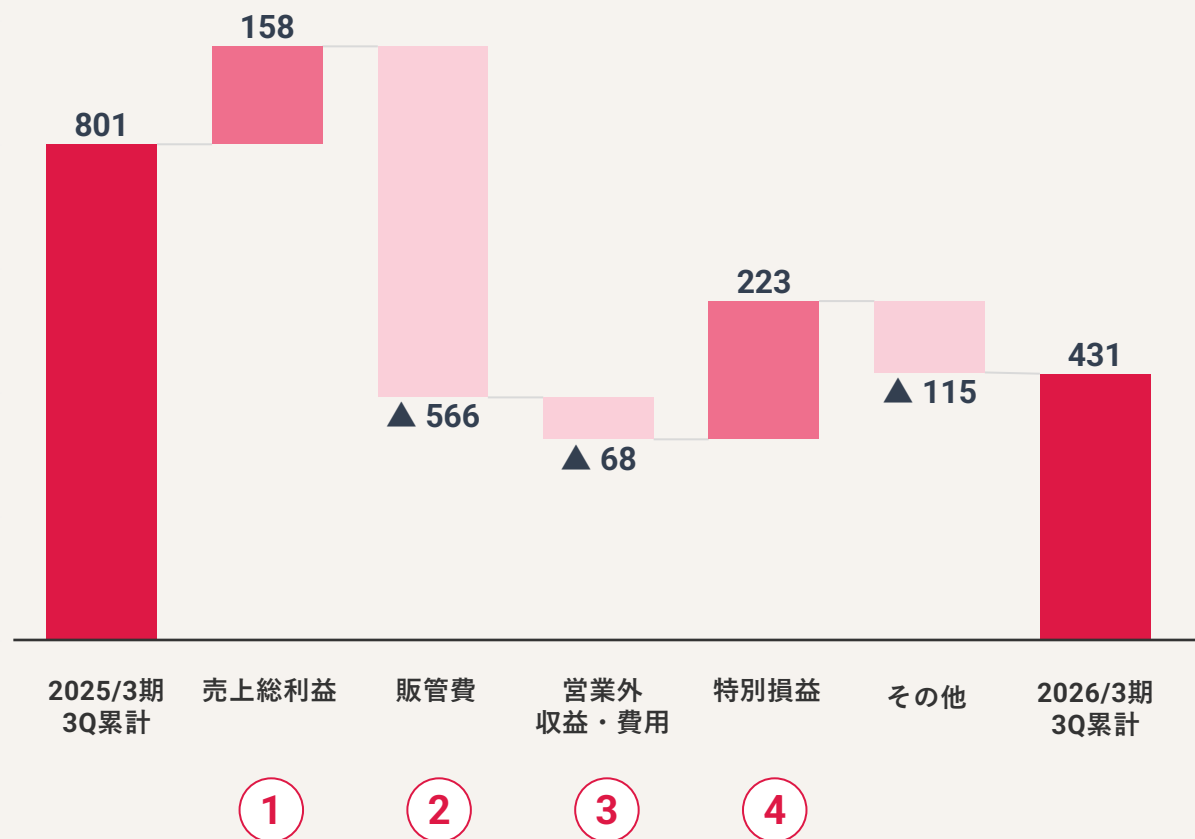


※百万円未満切り捨て、業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

## 02 純利益増減要因

マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

（単位：百万円）



※増減算出後、百万円未満切捨て

### 利益増減要因

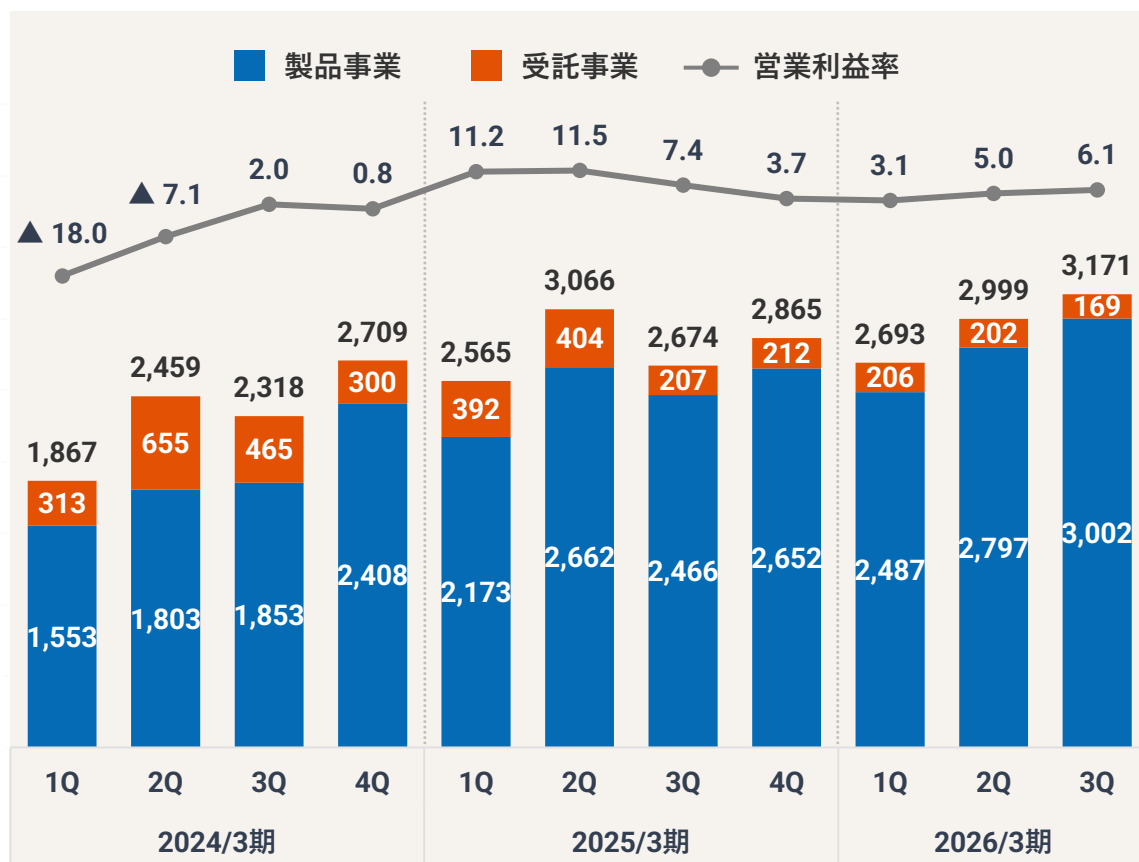
- ① 売上高は前年同期比で増加したことにより売上総利益が増加しました。
- ② 人件費及び輸出に関わる送料を中心に販管費が大幅に増加しました。
- ③ 賃貸契約の見直しによる受取賃貸料の減少で営業外収益が減少しました。
- ④ 子会社化した株式会社ウジケの負ののれん発生益により特別利益が増加しました。

## 02 四半期業績推移（連結）

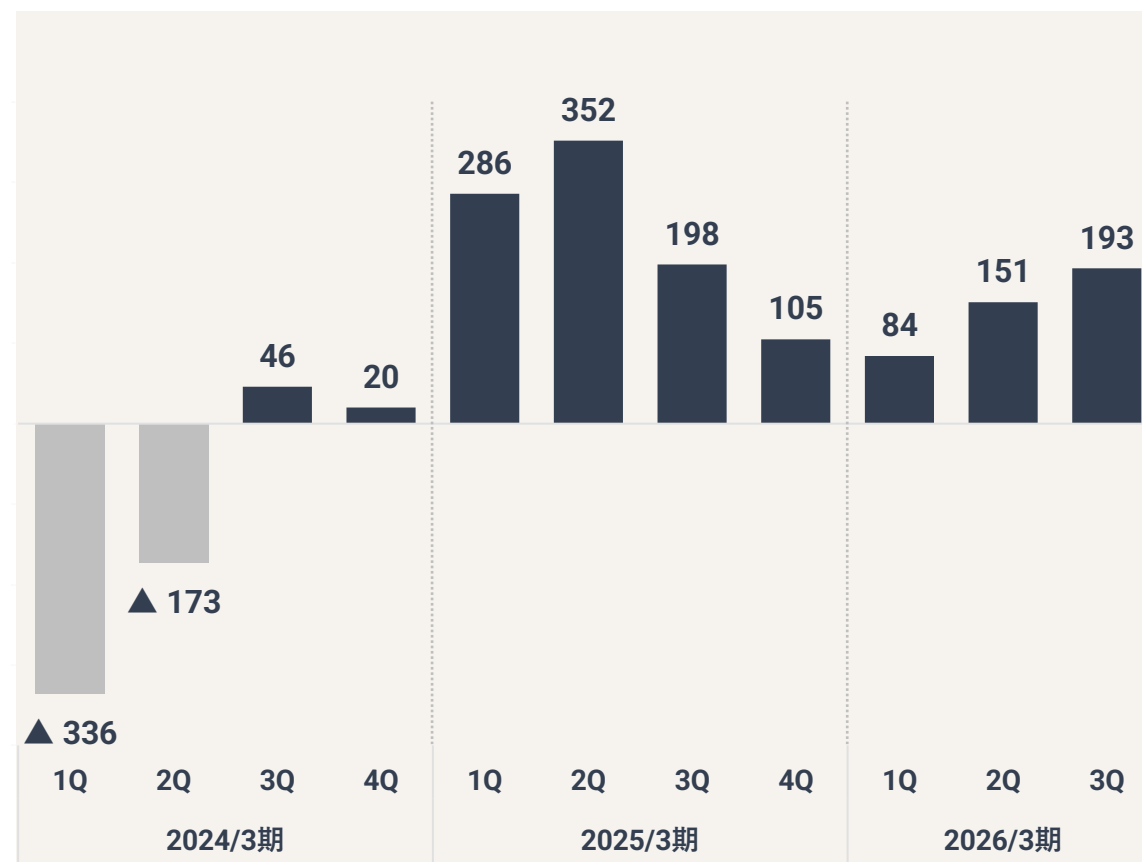
マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

売上高は製品事業が前期に引き続き堅調に推移している一方で、受託事業は前期第3四半期と比べて減少しました。営業利益は、ベースアップによる人件費の増加や、J-ESOP関連費用の計上に加え、段階的に解消が進んでいるものの一部残存していた輸送コストの影響等により、前年同期比で若干減少しました。

### 売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



### 営業利益（単位：百万円）



※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

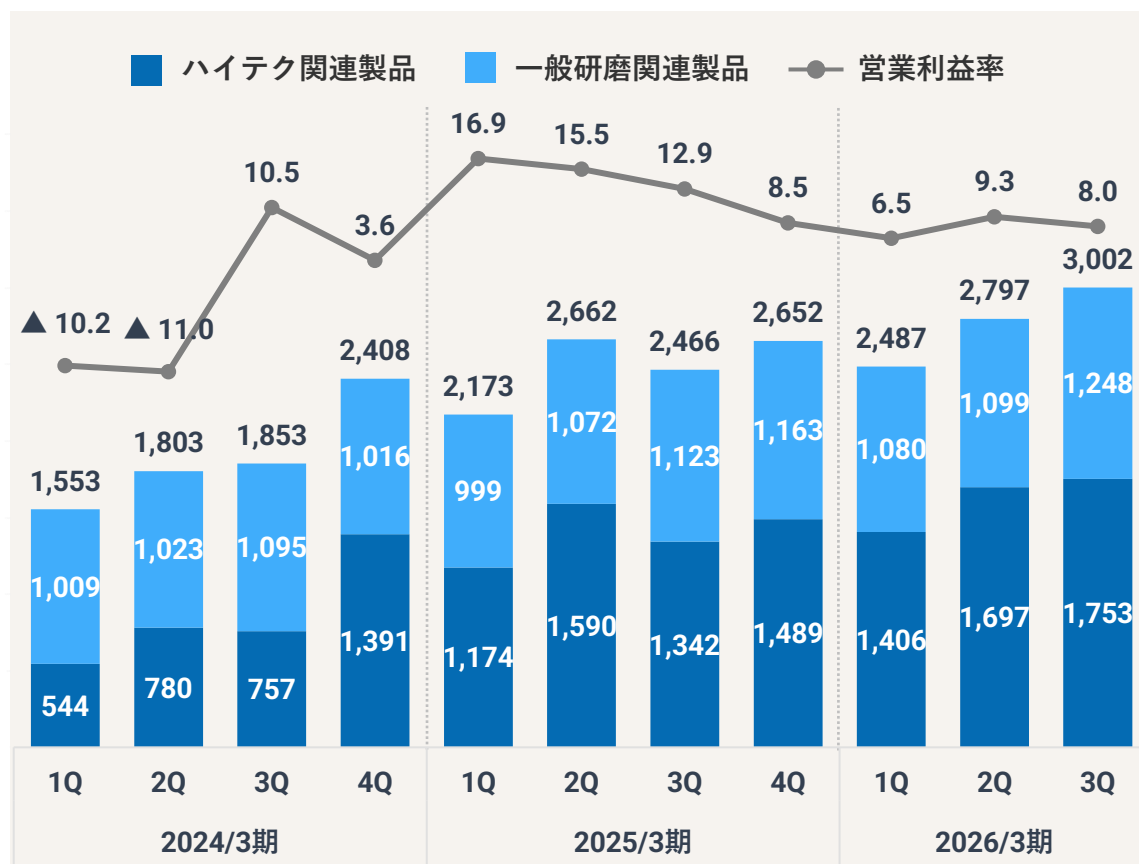
## 02 四半期業績推移（製品事業）

マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

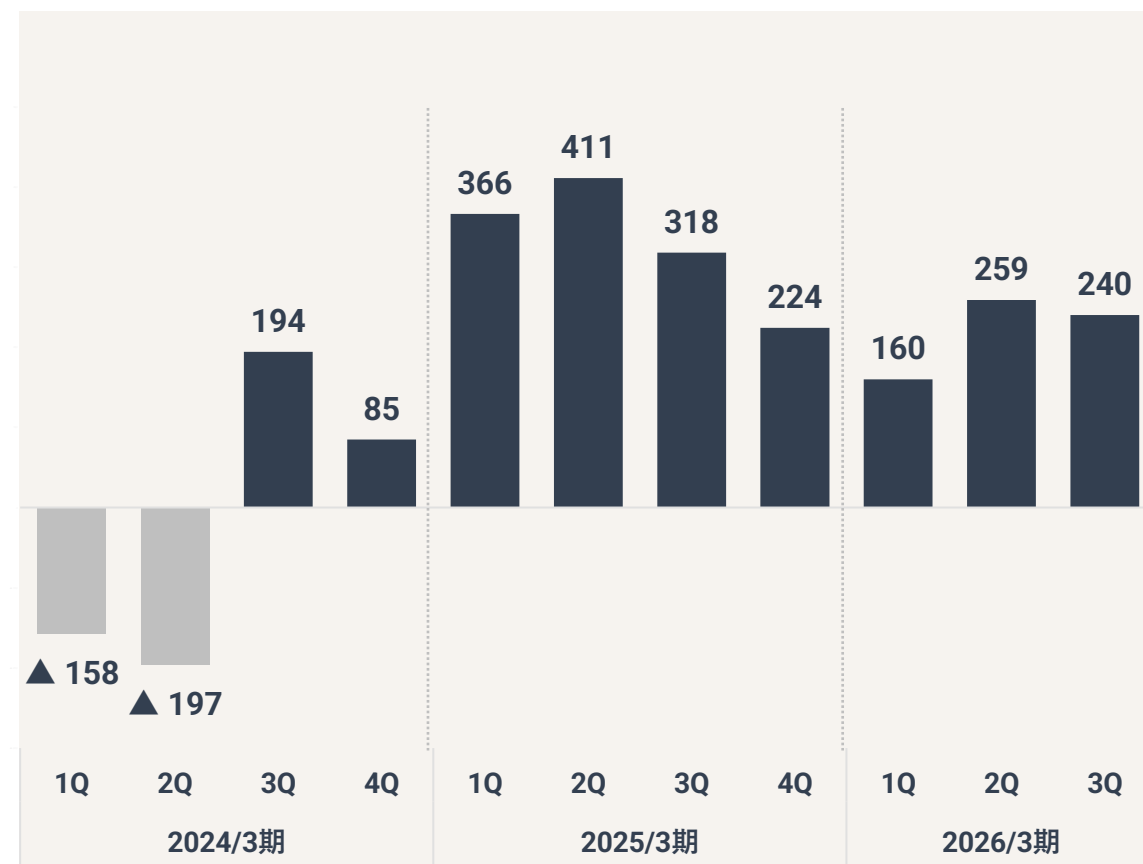
当第3四半期においてもハイテク関連製品ならびに一般研磨関連製品は堅調に推移しました。

利益面では受託事業の落ち込みによる共通固定費の負担率の上昇及び販管費が増加したことによりセグメント利益が前年同期比で減少しました。

### 売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



### 営業利益（単位：百万円）



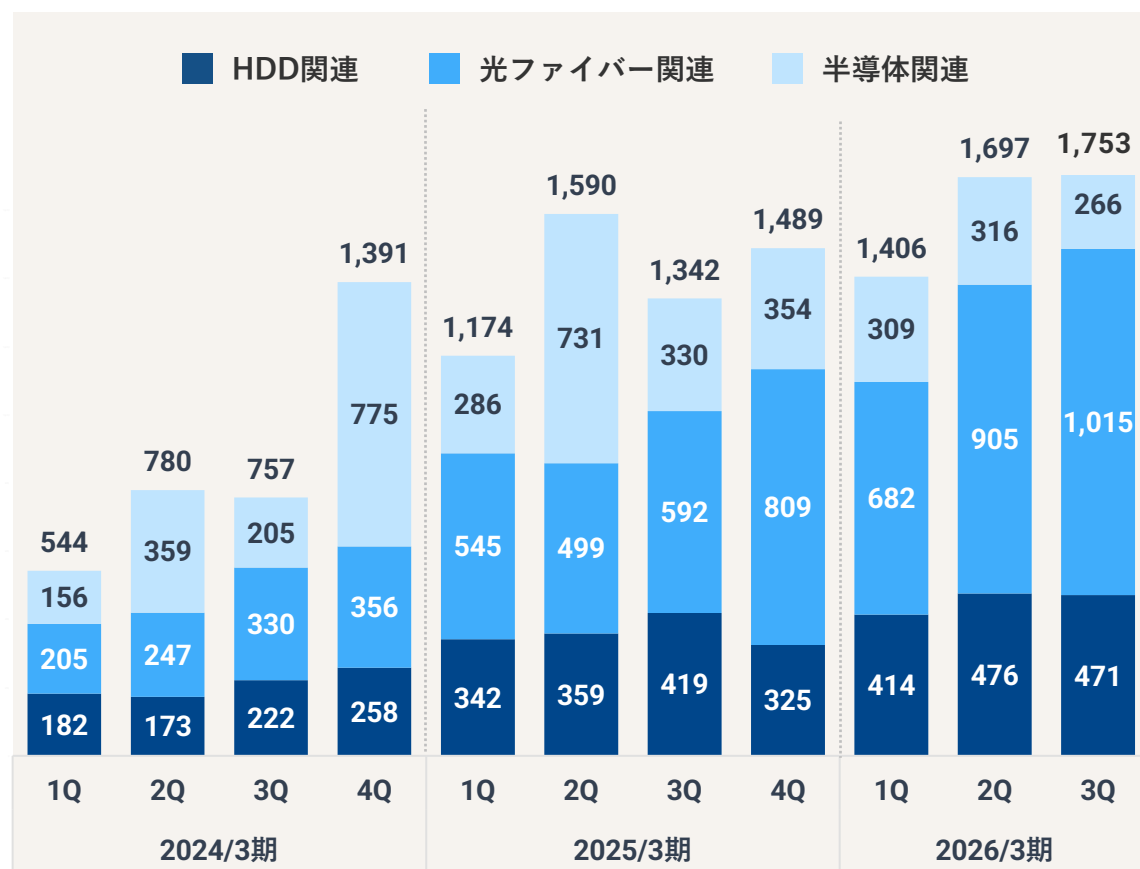
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

## 02 業績推移（製品事業内訳）

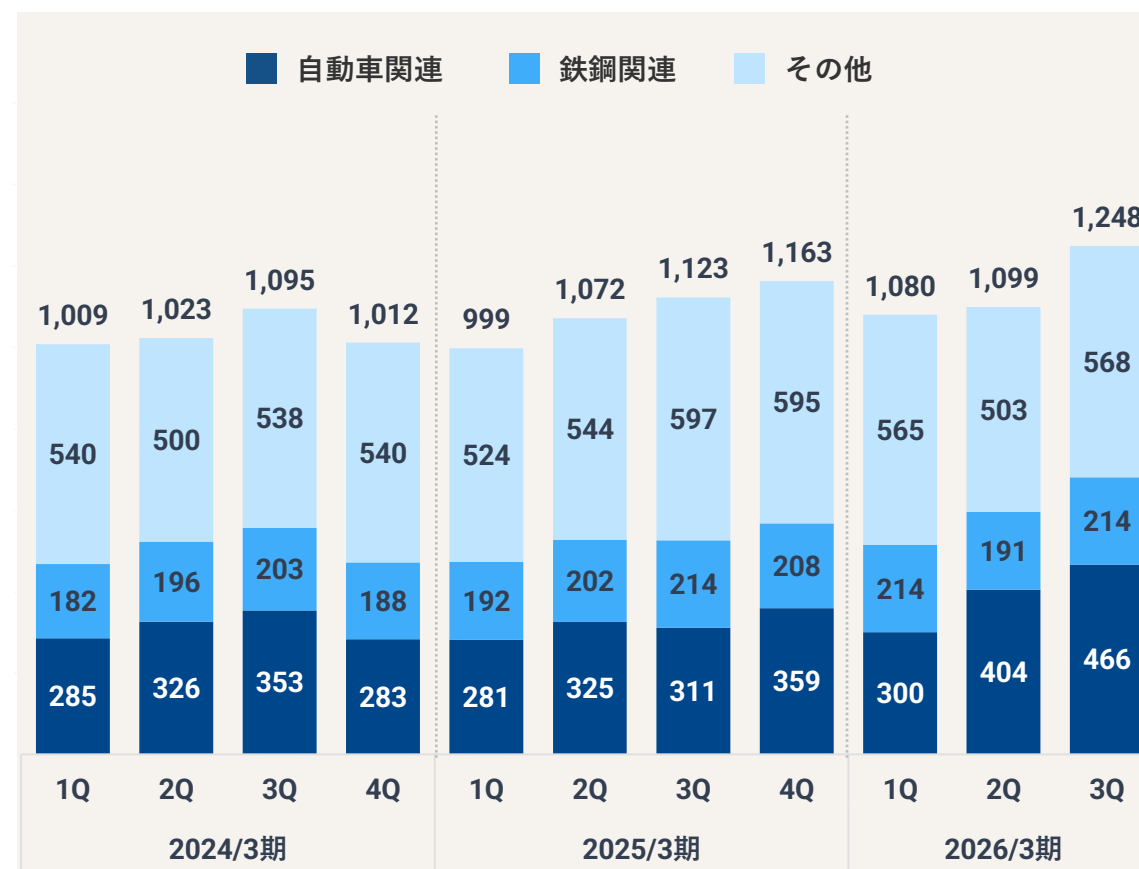
マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

ハイテク関連製品はデータネットワーク分野が依然好調であり、HDD関連及び光ファイバー関連の売上高は高水準で維持しています。一方で半導体関連は海外向けの一部主要製品において顧客の調達方針変更等の影響を受け、売上が減少しました。現在は製品性能の改善を進め、回復に向けた取り組みを行っています。一般研磨関連製品は建築関連の低迷によりその他が前年を下回りましたが、自動車関連製品は、主要顧客向け出荷の増加や競合製品からの切り替えの進展、ならびに新営業拠点の売上拡大を背景に、順調に売上を伸ばし前年同期を上回りました。

ハイテク関連製品（単位：百万円）



一般研磨関連製品（単位：百万円）



※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

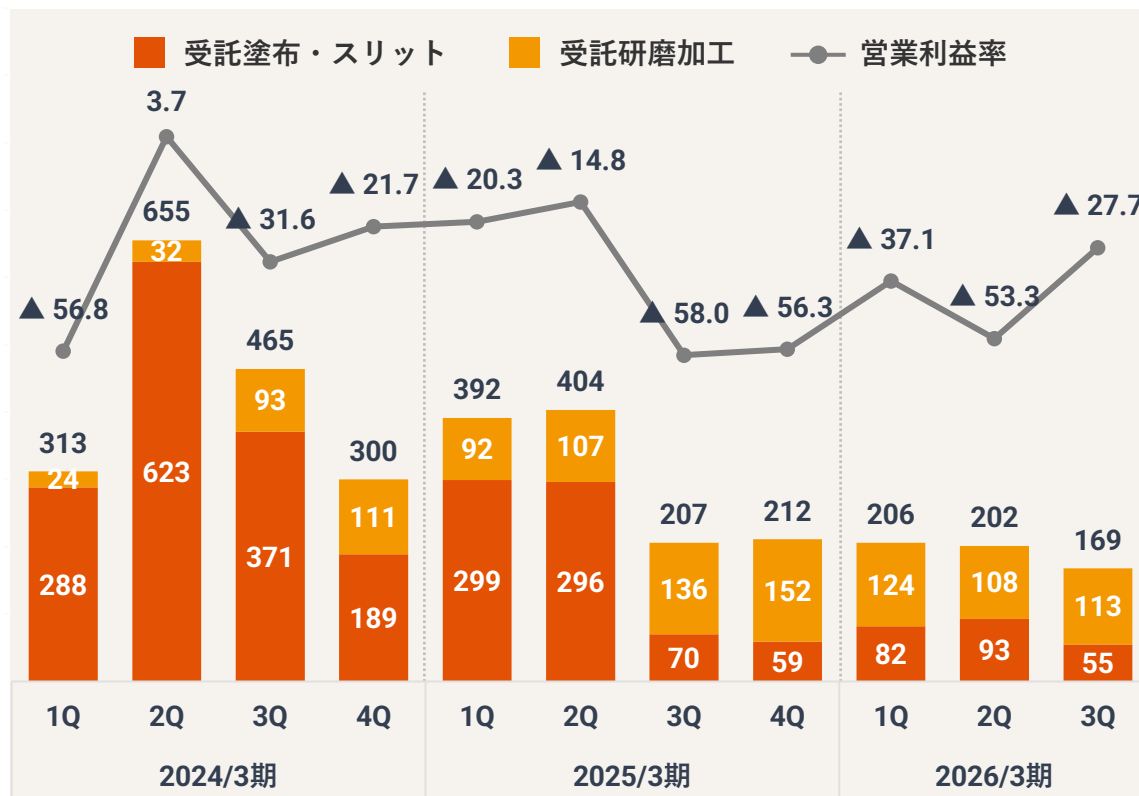


## 02 四半期業績推移（受託事業）

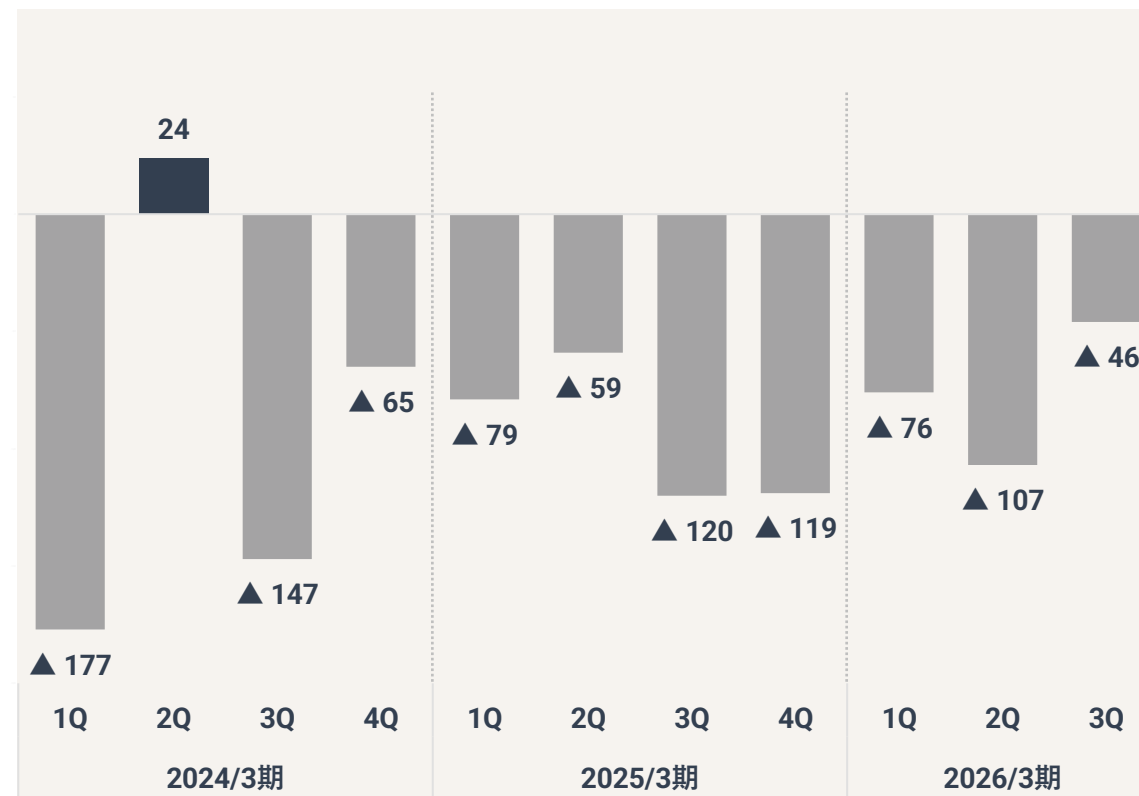
マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

当第3四半期の売上高は低調に推移し引き続き営業損失を計上する結果となりました。受託塗布・スリット事業は材料費の高騰等により量産の為の試作案件獲得に苦戦しました。売上高は減少したものの、試作案件の減少に伴い人員や設備の一部を製品事業へ活用するなど、固定費の抑制に努めた結果、損失幅は前年同期比で縮小しました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



営業利益（単位：百万円）



※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

## 02 BSサマリー

マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

（単位：百万円）	2025/3期末	2026/3期 12月末	増減額	備考
流動資産合計	8,465	9,760	+1,295	
現金及び預金	2,407	2,447	+40	
売上債権*	2,693	3,203	+510	当第3四半期売上の増加に伴う売上債権の増加
棚卸資産	2,924	3,504	+579	需要増加に伴う在庫の積み増しによる増加
その他	439	605	+165	
固定資産合計	7,465	7,590	+124	
有形固定資産	6,737	6,764	+27	
資産合計	15,931	17,351	+1,419	
流動負債合計	5,438	6,620	+1,181	
支払手形及び買掛金	945	897	▲ 48	
短期借入金（社債含む）	3,363	4,685	+1,321	運転資金を目的とした短期借入による増加
その他	133	268	+135	
固定負債合計	2,028	1,948	▲ 80	
長期借入金（社債含む）	1,857	1,705	▲ 151	
負債合計	7,467	8,569	+1,101	
純資産合計	8,463	8,782	+318	
負債純資産合計	15,931	17,351	+1,419	

\*売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

\*増減算出後、百万円未満切捨て

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2025年5月12日	1Q	商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ	<a href="#">P3 別途資料</a>
2025年8月1日	2Q	株式会社ウジケの全株式取得に関するお知らせ	<a href="#">別途資料</a>
2025年8月1日	2Q	自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)	<a href="#">P26 別途資料</a>
2025年9月5日	2Q	ヴァンフォーレ甲府とスポンサーシップ締結	<a href="#">別途資料</a>
2025年9月18日	2Q	九州工業大学とMipox*、半導体向け研磨フィルムの外観検査工程におけるAI自動化の実証実験を開始	<a href="#">別途資料</a>
2025年10月1日	3Q	商号変更およびコーポレートロゴ刷新のお知らせ	<a href="#">P3 別途資料</a>
2025年11月11日	3Q	リフレクターブランド「Ref Lite（レフライト）」新製品に関するお知らせ	<a href="#">P19 別途資料</a>
2025年11月27日	3Q	中高生と社員が共創するモノづくりプログラム「Mipox X Challenge Program」を始動	<a href="#">P20 別途資料</a>
2025年12月18日	3Q	結晶転位高速検査装置「XS-1 Sirius」の8インチウェーハ評価対応開始	<a href="#">P21 別途資料</a>

※1：リリースは旧社名「Mipox株式会社」発表のもので、現在は「マイボックス株式会社」に商号変更しております。

## 02 トピックス リフレクターブランド「Ref Lite（レフライト）」新製品に関するお知らせ (2025年11月11日)

マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

日本初\*1のリフレクター（再帰性反射布）ブランド「Ref Lite（レフライト）」シリーズの薄型軽量リフレクターシリーズの新たなラインアップとして、「Ref Lite ウルトラライトリフレクター カラーシャインブラック」を2025年11月より販売開始



2022年より販売している人気シリーズ、薄型・軽量「Ref Lite ウルトラライトリフレクター」の新たなラインアップとして、当社初の黒色のリフレクターを開発。



特長

- 従来の白いリフレクター製品のイメージを覆す、黒色のリフレクター
- 通常時は黒色でダークトーンのベースに馴染むが、暗闇での再帰反射時には一転、黄色・青・赤のいずれかに光る3色展開

\*1：オープンレンズタイプの再帰性反射布として国内で初めて製造販売（1968年の発売当時、当社調べ）

【「反射材フェア2025」でRef Lite（レフライト）が採用】



2025年10月に池袋サンシャインシティで行われた全日本交通安全協会主催「反射材フェア2025」で実施された反射材ファッションショーの衣装に、「Ref Lite（レフライト）」が採用されました。





株式会社リバネス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長COO：高橋修一郎）と当社は、次の100年を見据えた人材の育成を目指す教育プログラム「Mipox X Challenge Program」を開始しました。

## 「Mipox X Challenge Program」の概要

**コンセプト** 「X（かける）＝掛け合わせる力」

**内 容**

- ・「人の感覚による磨き」を研磨技術に応用し再現する
- ・参加チームはオリジナルの研磨装置を設計・改良し、競い合う

**スケジュール**

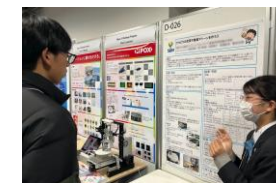
2025年 プレ実施 ⇒ 2026年6月 本格始動（予定）

**特 徴**

- ・実社会を支える産業技術を体験的に学べる
- ・科学・技術・芸術を横断するSTEAM教育\*の実践型プログラム
- ・世代や専門分野を越えた「共創」を促進する学びの場
- ・研磨・表面制御・自動化など、産業技術と創造的発想をつなぐ学際的テーマ

\*STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でAを定義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習

## 【サイエンスキャッスル2025で研磨体験プログラムを実施】



2025年12月13日(土)・14日(日)、東京科学大学にてされた「サイエンスキャッスルワールド2025」に、パートナー企業として協賛。

当社は本イベントにおいて、特別企画「Mipox X Challenge Program『研磨の力で、究極の光るどろだんごをつくりだせ!』」を実施。多くの中高生の皆様にご参加いただき、研磨技術の可能性と面白さを体験していただく機会となりました。

当社は半導体結晶ウェーハ内部に存在する貫通転位プロファイルを高感度かつリアルタイムに可視化する「XS-1 Sirius」において、8インチウェーハの評価対応を開始したことをお知らせしました。今回の8インチ観察対応を始め今後も大型化が進むパワー半導体用ウェーハに対応していくことで、ウェーハ製造プロセスの安定化や欠陥低減を支援し、高品質パワー半導体ウェーハの供給安定に寄与します。



本プロジェクトで大口径半導体ウェーハ用の光学観察系及び画像タイリングソフトウェアを開発し、偏光観察手法を用いた非破壊観察による8インチウェーハの全面評価が可能となりました。

#### NEDO\*委託事業による研究開発成果

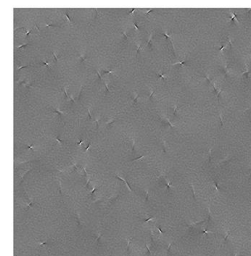


本研究開発の成果は、NEDOの委託事業（グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築プロジェクト／次世代パワー半導体に用いるウェーハ技術開発）により得られたものです。

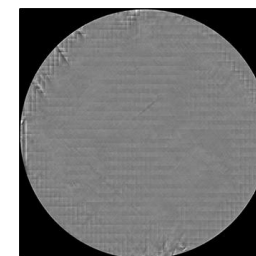
\* NEDOプロジェクトについてはp46をご参照ください。

#### 【8インチシリコンカーバイド（SiC\*）ウェーハの評価事例】

8インチウェーハに最適化した光学観察・位相演算技術により、**非破壊でエッチングや放射光トポグラフィ観察に匹敵する高感度**で貫通転位の観察が可能に。



偏光観察により撮影された  
市販昇華法SiCウェーハ内部の貫通転位

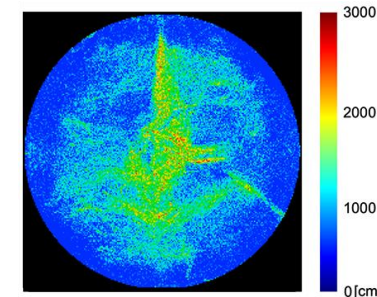


市販昇華法SiC8インチウェーハ  
全面の偏光観察データ

観察された画像からウェーハに含まれる貫通転位を  
カウントし、転位密度をカラースケールで表示

8インチウェーハにおいても  
**ウェーハ品質の客観的な評価が可能**

市販昇華法SiC8インチウェーハに含まれる貫通転位密度のヒートマップ ▶



# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix



(百万円)	リリース日	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
期初予想 (A)	2025年5月15日	11,000	900	1,000	700
修正予想 (B)	2025年11月14日	11,000	600	600	550
2025年3月期実績		11,172	942	855	911
増減額 (B-A)		0	▲300	▲400	▲150
増減率		-	▲33.3%	▲40.0%	▲21.4%

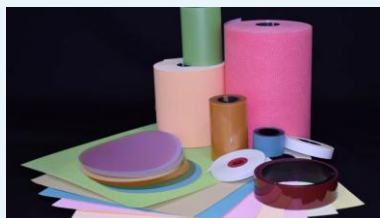
※増減算出後、百万未満切捨て

## 【コメント】

- 第2四半期の下方修正（B）の主な要因は、上期に発生した一時的な損失によるもので、具体的にはハイテク関連製品の需給逼迫に伴う輸送費の増加及び米国関税措置の影響により通期の収益を押し下げたためです。下期には契約条件や供給体制の見直しにより状況は改善しつつありますが、上期に発生したコストの増加を十分に吸収するのは難しいことが見込まれるため、下方修正に至りました。その結果、2026年3月期の営業利益は6億円、経常利益は6億円、親会社株主に帰属する当期純利益は5.5億円を予想しております。
- ハイテク関連製品は光ファイバーを中心に堅調に推移しており、基盤事業としての成長を続けております。引き続き、ECを活用した販売チャネルの多様化や製造DXによる工場の自動化・省力化を通じ、コスト構造の改善を進めてまいります。また、将来を見据えた人材育成をはじめとする人的資本への投資にも注力し、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

米中関係や米国による関税措置など、依然として不透明な外部環境要因が残存していることから、市況全体の本格的な回復には慎重な見極めが必要であると認識しております。また、国内政治や経済・財政、通商政策の動向を含む内外環境の変化を踏まえ、引き続きリスク管理の徹底に努めてまいります。

### ハイテク関連製品



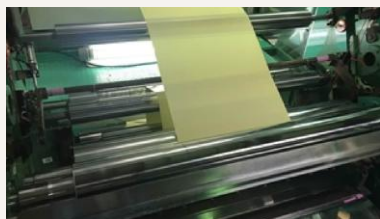
- ・生成AI関連を含む米国における光ネットワーク投資を背景に、光ファイバー関連製品の需要は引き続き堅調に推移しております。契約条件の見直しにより関税の影響はすでに解消しており、また納期の改善に伴い、イレギュラー案件を除いて船便対応を継続することで、輸送コストの抑制を図っております。
- ・HDD市場はクライアント向けからデータセンター向けへシフトしました。生成AIの普及に伴うデータ爆発を背景に、ニアラインHDDを中心に出荷数量もプラス成長へ回帰しています。さらに、HAMR（熱アシスト磁気記録）等の次世代技術の導入により、さらなる高精度化が加速しています。こうした市場の再成長と技術革新を追い風に、当社の研磨フィルム需要は今後も上向きに推移する見通しです。
- ・半導体関連は工場稼働率が低水準にある中、顧客の在庫調整により第3四半期は一部減少したものの、生成AI向け需要拡大を背景にプローブカードクリーニング製品の販売は増加傾向にあり、通期では前期並みの売上を維持する見通しです。第4四半期には装置検収による業績への寄与を見込んでおります。

### 一般研磨製品



- ・原材料及びエネルギーコストは依然として高水準にあり、今後も厳しい事業環境が続く見通しです。そのような状況下においても、顧客価値を最優先とし、柔軟な対応を継続してまいります。
- ・新規営業拠点（仙台、鹿沼、金沢、熊本）は順調に成長しており、地域密着型営業の成果が着実に表れております。あわせて、製品価格改定も円滑に進捗しており、IT及びECサイトの活用やウジケ社の取り組みを通じて、営業力のさらなる強化を図ってまいります。
- ・IH粉体塗装事業におけるシステム導入提案につきましては、政府助成金を活用しながら、試作案件を通じて顧客に対し具体的なソリューションを継続的に提供してまいります。

### 受託塗布・スリット



- ・ 量産獲得が難航し、足元では顧客側の開発予算調整等の影響から試作案件も一時的に鈍化しております。しかし、来期以降の製品化を見据えた技術相談や引き合いは着実に増加しており、市場のポテンシャルは依然として高い水準にあります。
- ・ 用途はこれまで半導体関連及びディスプレイ関連が中心であった中、新たに建材関連の試作対応を開始しており、今後の成長に向けた足掛かりとなる可能性があります。
- ・ 潜在案件の確実な受注獲得に向けた活動を強化するとともに、オウンドメディアの活用や積極的な販促活動を通じ、新規顧客の開拓を加速させてまいります。当面は、次世代の量産案件に繋がる試作対応を軸に、事業基盤の拡大に注力してまいります。

### 受託研磨加工



- ・ 高付加価値CMP案件の受託拡大を見据え、前期比で売上増を見込んでおります。測定機、CMP装置、洗浄機等の設備を順次導入し、サービス受け入れ体制は下期末までに整う予定です。2026年3月期において量産に直結するケースは限定的ではあるものの、一部の案件では継続的な加工及び数量の増加が見込まれております。
- ・ 注力している先端材料の高難度加工技術の実績積上げにより、GaN基板、ダイヤモンド基板など次世代パワーデバイス用基板の研磨受託加工が引き続き堅調で増加が見込まれます。
- ・ 従来の研磨加工に加え、接合や洗浄など前後工程も含めた一括受託体制を整備し、製造プロセス全体をカバーするファウンドリーサービスを推進しています。さらに、米国企業との協業を通じて、受託加工、エッジポリッシャー販売、CMP技術の共有、営業ネットワークの活用を行い、国内外での事業拡大を目指します。

当社は将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対しては安定配当を目指しつつ、業績等を勘案して、適正な利益還元に努めております。

## 配 当

2026年3月期は配当については、通期業績の確定を受けての判断になりますが、期末配当10円を予定しております。

年 間 配 当	
2024年3月期	無 配
2025年3月期	10 円
2026年3月期	10 円（予想）

## 自 社 株 買 い

資本効率の向上、及び株主還元の充実を図るため、2025年5月15日開催の取締役会における決議に基づき2025年5月16日から2025年7月31日の期間で自己株式の取得を実施いたしました。

取得株式総数	当社普通株式395,800株(上限:50万株)
株式取得総額	199,971,700円(上限:2億円)
取得期間	2025年5月16日から2025年7月31日まで
取得方法	東京証券取引所における市場買付
ご 参 考	2025年3月31日時点の自己株式の保有 発行済株式総数（自己株式を除く）： 14,422,368株 自己株式数： 29,552株

# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

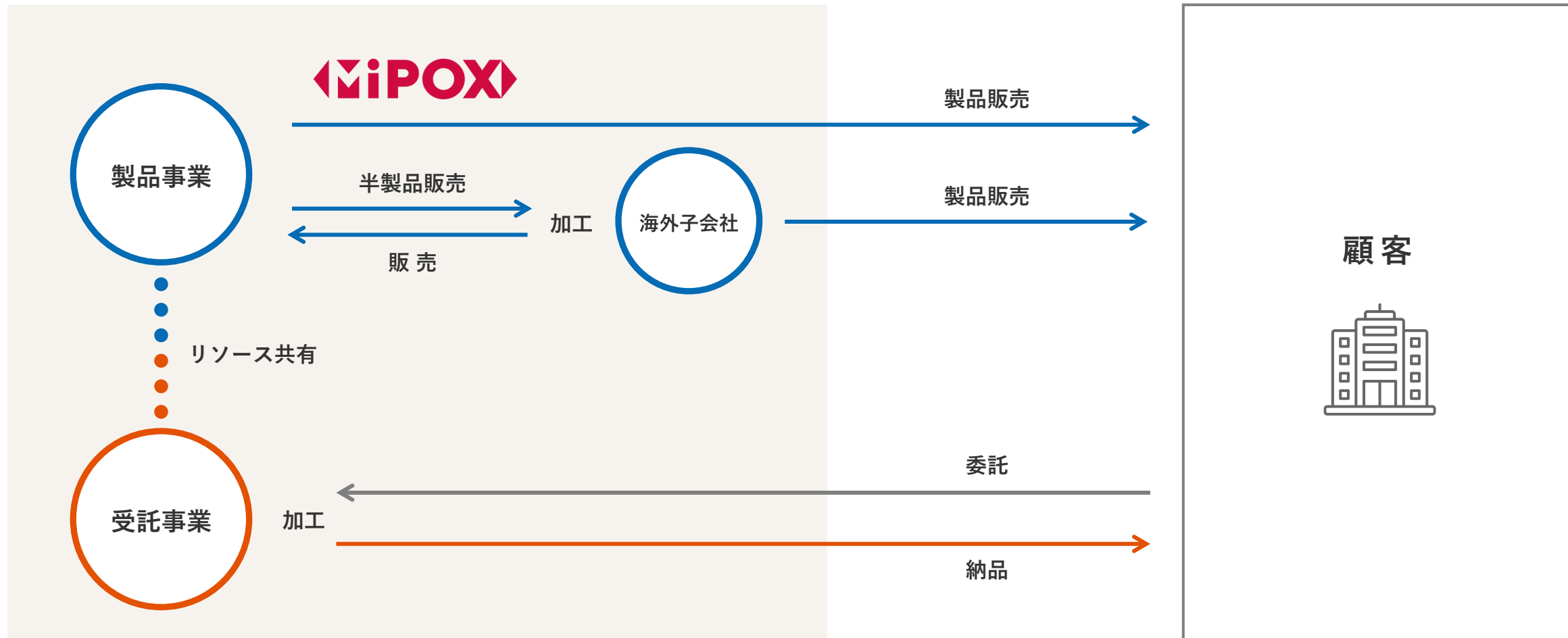
Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

海外工場での加工を経ることにより、日本のみに工場が存在するよりも様々な製品を効率よく製造しております。海外向けに販売も行っております。顧客からの委託を受けて加工も行っており、自社製品のみならず顧客の要望に合わせたサービス・製品も提供しております。



## 製品事業

研磨材の開発・製造・販売を行っております。

超精密研磨から一般研磨まで、幅広いニーズに対応する製品を展開しており、装置や反射材なども含め、世界中の多様な用途に向けて提供しています。



研磨フィルム



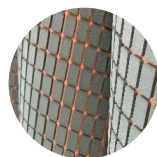
液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



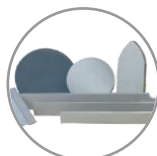
研磨周辺機器



検査装置



再帰性反射材  
(Ref Lite)



ヤスリ製品



IH粉体塗装

## 受託事業

### 【受託研磨加工】

半導体ウェーハをはじめとする材料を顧客より預かり、当社が保有する設備（研磨装置、洗浄機、検査装置）と独自の研磨材を用いて、要望に沿った研磨加工を提供しております。

### 【受託コーティング・スリット】

顧客の基材（フィルム等）や塗料材を預かり、当社が保有する設備（調合、コーティング、スリット）を用いてフィルム化、裁断を行っております。



塗布製品



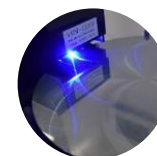
研磨加工



スリット加工



常温接合加工



検査

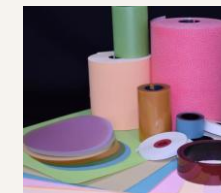


## 世界を磨き上げる。

世界中の産業・暮らしの中で求められる精度と品質。マイボックスは“研磨”の力で、それを静かに支えています。半導体、光ファイバー、自動車、楽器など、あらゆる分野で当社の技術が、世界のスタンダードを磨き上げています。



## 当社が販売する研磨関連製品例



### ハitek分野（研磨剤）

ハードディスクや光ファイバー、半導体といった高精度な研磨が求められるハitek分野向けに使用



### 一般研磨分野（研磨剤）

航空機・船舶・自動車のボディ、楽器や建築関連の木工部品などに使用



### 研磨・観察装置

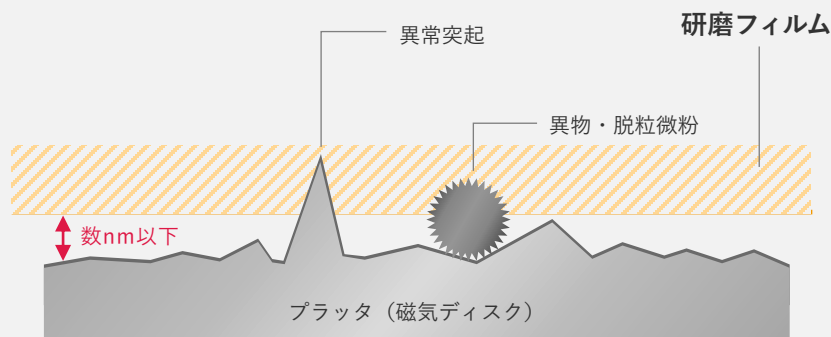
（左）エッジ研磨装置  
（右）結晶転位高感度可視化装置 XS-1 Sirius

ハードディスクドライブ（HDD）内部のプラッタと呼ばれる磁気ディスクの表面研磨に当社製品を使用。ヘッド部に接触しないよう、1000分の1μ程度の突起や異物を除去します。各ハードディスクメーカーの仕様に応じたカスタマイズ製品を製造・供給しています。



### ハードディスクドライブ（HDD）の研磨

当社の研磨フィルムは、独自のバインディング技術とスリット技術により、研磨フィルムから砥粒や異物がディスク上に残らないよう設計されています。この高度な技術は非常に高い難易度を誇り、他社が模倣することが難しい当社の競争力の源です。

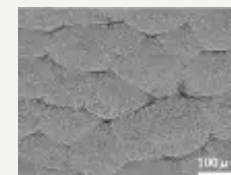


### マイボックスの強み

Strength

#### 01 カスタマイズ可能

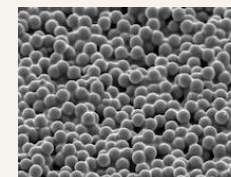
「塗る」技術の活用により、研磨層表面の形や大きさ、溝の深さ・粗さ等、各社に合わせた研磨フィルムを提案可能です。



Strength

#### 02 球状で傷をつけない

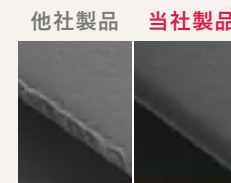
「塗る」技術の活用により、フィルムに球状の研磨材を均一に塗布。表面突起がないため、ディスクに傷をつけずに異物の除去が可能です。



Strength

#### 03 端面まで高精度

「切る」技術の活用により、研磨フィルムの高精度な端面を実現。研磨時の傷の軽減など、品質向上に寄与しています。



ガラス製のファイバー線と、それを保持するフェルール（酸化ジルコニウム製）を研磨することで、接触面を滑らかにし、光信号の損失を最小限に抑えることができます。これにより、通信の質が向上します。先端に付着した樹脂の除去から、鏡面化までを当社の製品で行います。

## 単芯タイプ 光ファイバーの研磨工程例

1本の光ファイバー線で構成。安価で長距離通信が可能。一般消費者向けネット通信（テレコム）等々に使用される。



## 多芯タイプ 光ファイバーの研磨工程例

12～24本の光ファイバー線で構成。高価で付加価値が高い。短距離通信限定+大容量通信が可能でデータセンター等に使用される。



## マイボックスの強み

Strength

### 01 環境負荷を低減

廃液を排出するスラリーに代わり植毛フィルムを使用することで、廃液問題の解消と環境負荷の低減を実現。環境基準が厳格な国々において、当社の製品は優位性を発揮します。

Strength

### 02 研磨材メーカーの製品力

研磨材メーカーとして、基材・砥粒・パインダーの多様な組み合わせにより、最適な製品を提供可能です。

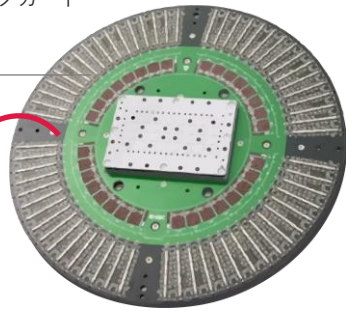
Strength

### 03 研磨ニーズへの対応力

精密業界で培った長年のノウハウを活かし、研磨条件の最適化を提案し、さまざまな要求に柔軟に対応します。

半導体製造工程の中の、主に前工程であるウェーハ検査工程で使用される検査用器具「プローブカード」のクリーニングシートを提供。多くの半導体関連メーカーへの提供実績があり、幅広い製品ラインナップで、あらゆるタイプの針先クリーニングに対応いたします。

プローブカード



### ウェーハ検査用「プローブカード」の針先研磨

「プローブカード」とは、半導体のウェーハ検査工程で使用される検査用器具です。プローブ針からウェーハに電気を流し、正常に動作するか検査を行います。このプローブ針の汚れのクリーニング及び先端形状の保持に、当社のクリーニングシートが使用されております。

プローブカード

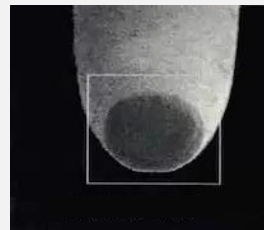
プローブ針

ウェーハ

針先クリーニング前



針先クリーニング後



### マイボックスの強み

Strength

#### 01 針を摩耗せず汚れを除去

当社のクリーニングシートは針を摩耗せずに汚れの除去が可能です。高価なプローブカードの寿命を延ばすことに寄与します。



Strength

#### 02 豊富な製品ラインナップ

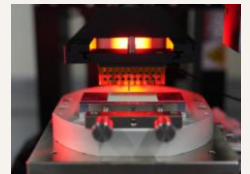
プローブ針には丸・フラット・クラウン等、様々な形状があり、それぞれの形状に合わせたクリーニング製品を提供可能です。



Strength

#### 03 様々なテスト環境に対応

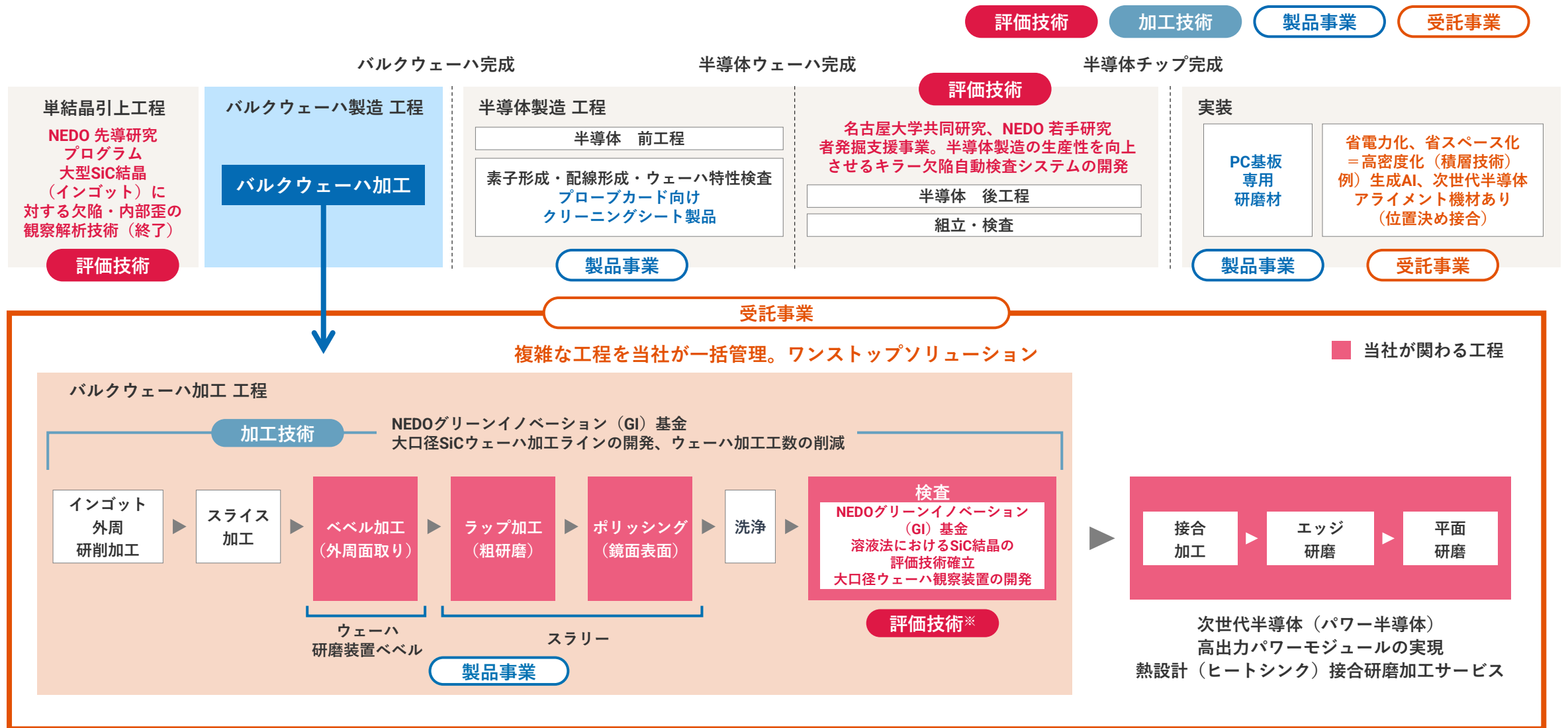
低温から高温まで、様々なテスト環境に対応した製品を取り揃えております。





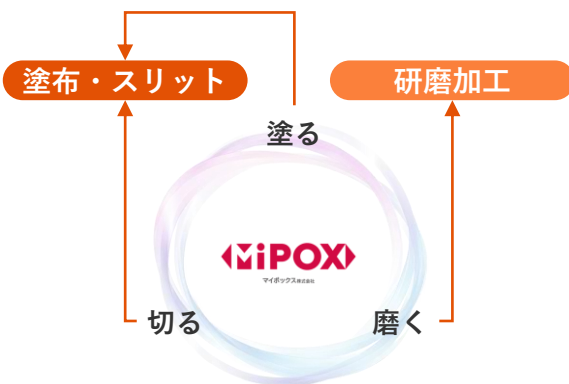
# 04 半導体サプライチェーンにおける当社の技術と事業区分

マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）



※NEDOグリーンイノベーション基金での支援事業は社会実装までは利益を上げることが出来ず、収益化は社会実装後になります。

受託事業では「塗る」と「切る」の技術を主とした塗布、スリット加工のサービスと、「磨く」技術を主とした研磨加工サービスを提供しています。



## 塗布・スリットの製造工程（塗る・切る）

各工程は個別でも一気通貫でも対応可

### 調合

塗料材の配合、ミキシング、分散



### コーティング

高精度の厚み制御とクリーンな環境での塗布



### スリット

塗布されたフィルムを切断



### 検査

塗布面、切断面を各種設備で検査



機能性フィルム製造実績  
（塗る・切る）

光学用粘着フィルム / 光制御フィルム / ディスプレイ向けフィルム / 半導体向けフィルム / 導電性フィルム / 化粧シート / 加飾・転写フィルム / 表示デバイス 他

## 研磨加工（磨く）

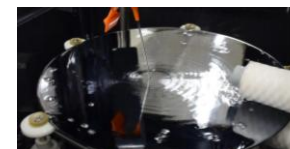
### 平面研磨（CMP）



### エッジ（ノッチ）研磨加工



### 精密洗浄



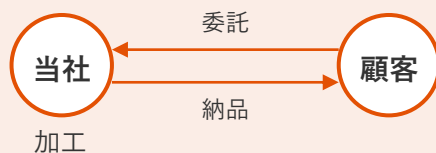
### 常温接合



多様材料への研磨加工実績  
（磨く）

半導体ウェーハ素材（シリコン / 化合物半導体〔例：GaN, SiC〕 / ファインセラミックス / 酸化物材料 / ダイヤモンド / 金属 / ガラス 等）、3Dプリント造形物 他

## サービスの流れ



# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix



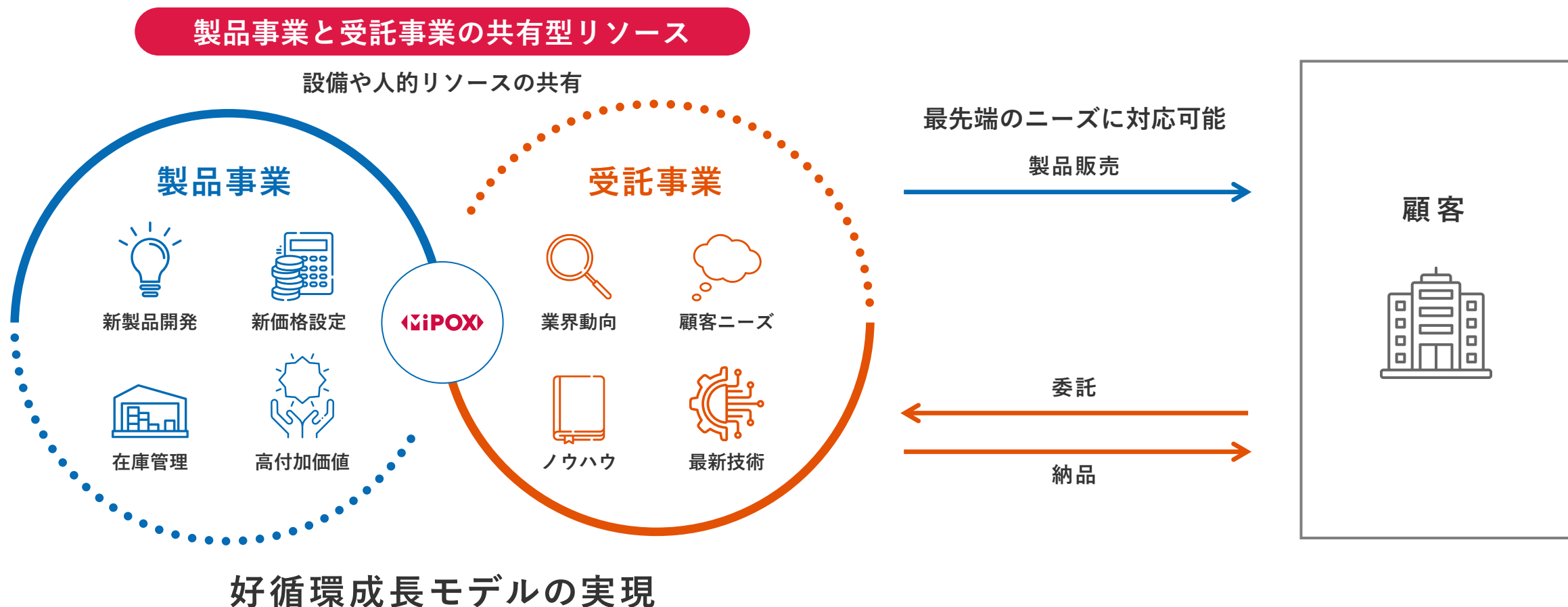
1 事業間で発揮されるシナジー効果

2 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

3 スマートファクトリー



製品事業と受託サービス事業では設備や人的リソースを共有しており、技術やノウハウの蓄積に役立っております。  
蓄積された技術やノウハウは高付加価値のある製品やサービスの創出に活かされ、顧客の多様な要望を実現する源になっております。



## 05 競争力の源泉② 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

マイボックス株式会社 2026年3月期 第3四半期決算説明資料（証券コード5381）

製品製造と受託加工ができるため、顧客の理想に合わせた製品の作成、きめ細やかなサービスの提供が可能です。

各製造工程において異なる取引先との煩雑なやりとりを当社がワンストップで提供しており、顧客の要望が1つの窓口で完結いたします。

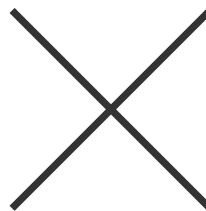
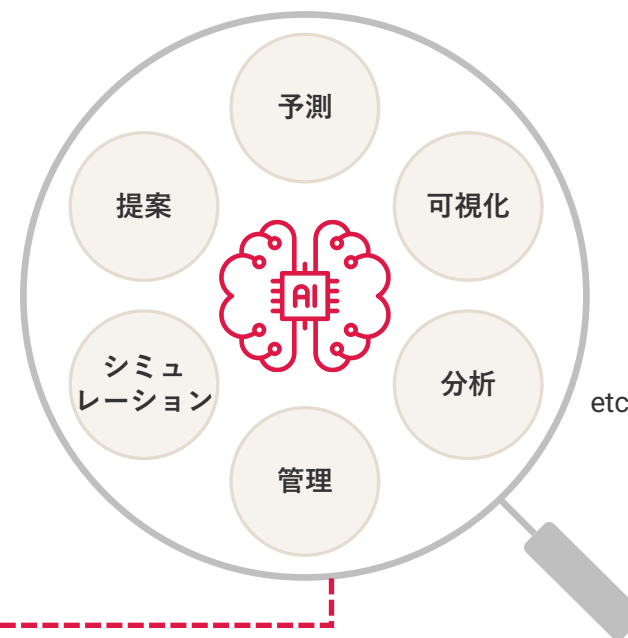


IoTとAIを活用し連携させることで、可視化しづらい部分の改善に役立つデータを収集しております。  
工場のDX化により、さらなる効率化・高品質化を目指します。

**IoT** あらゆる機器を連携させ、  
様々なデータを収集・蓄積



**AI** IoTで集めたデータを  
分析して課題が見える化



業務プロセスの改革

品質・生産性の向上

# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

# イノベーションに 磨きをかける。

最先端を研ぎ澄ます。  
次の100年を切り開き、  
世界の常識を塗り替える。

01



## 製品・受託事業領域の拡張

コア技術を基盤にM&Aや新技術導入を進め、塗装・研磨分野を中心に事業領域を拡大

02



## 鹿沼事業所の量産体制構築

本社を鹿沼事業所へ移転し、量産体制と研磨ラボを整備して生産能力を強化

03



## 産官学プロジェクトへの参画

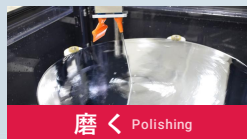
NEDOプロジェクトを通じ、次世代半導体やSiCウェーハ技術を開発し、社会実装を推進



塗る Coating



切る Slitting



磨く Polishing

「塗る・切る・磨く」を極めた技術力

コア技術を組み合わせ、お客様の成功に貢献する付加価値の高い製品とサービスを提供

当社の3つの技術ドメインである「塗る・切る・磨く」をプラットフォームとして、M&Aを重要な成長エンジンの一つとして活用し、事業拡張を進めております。

当社の技術 塗る 切る 磨く + 観る

	項目	内訳	関連企業の買収、事業及び知的財産の継承の実績			
製品事業	一般研磨 関連製品	一般研磨	<div>2016年</div> <div></div> <div>研磨布紙及びその他 研磨材製商品の製造・販売</div> <div><span>塗る</span> <span>切る</span> <span>磨く</span></div>	<div>2021年</div> <div></div> <div>フレキシブル・超高品 質なヤスリの開発・製造</div> <div><span>磨く</span></div>	<div>2022年</div> <div></div> <div>研磨ディスクの 製造・販売</div> <div><span>塗る</span> <span>磨く</span></div>	<div>2025年</div> <div></div> <div>株式会社 <b>ウシケ</b> フレキシブル・超高品 質なヤスリの開発・製造</div> <div><span>塗る</span> <span>磨く</span></div>
		産業分野関連				
	ハイテク 関連製品	電子部品関連				
		先端デバイス関連				
受託事業	受託塗布・スリット	Converting Solution（製造加工）				
	受託研磨加工	Processing Solution （研磨・洗浄加工）	産業分野関連		<div>2023年</div> <div></div> <div>金属パーツの精密研磨加工</div> <div><span>磨く</span></div>	
			先端デバイス関連			
		Evaluation Solution（観察・検査・評価）		<div>2018年</div> <div>◆現在は閉鎖</div> <div>有限会社 ビジョンサイテック◆</div> <div>観察・検査 装置の開発</div> <div><span>観る</span></div>		
市場開発・技術開発			<div>2015年</div> <div></div> <div>反射材製品、精密研磨 フィルム等の製造・販売</div> <div><span>塗る</span></div>		<div>2023年</div> <div></div> <div>スガ コーディングス</div> <div>有機溶剤不使用の コーティング事業</div> <div><span>塗る</span></div>	



当社のコア技術の一つである「塗る」に関連する技術であるIH粉体塗装技術を利用し事業展開を図っていきます。鹿沼事業所に開設した実証実験ラボの積極的な活用に加えて、IH粉体塗装技術を活用した自社製品の開発に向けて設備の導入を進めています。

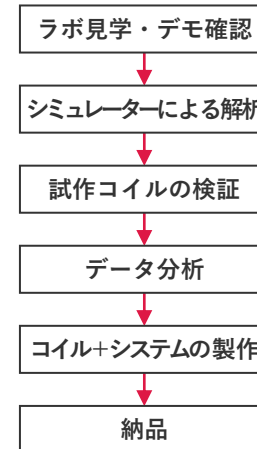
### 【実証実験ラボのIH粉体塗装システム】

特許取得済（特許第7560971号）



実証実験ラボ見学の様子

2023年3月に譲り受けた株式会社スガ コーディングスのIHを活用したコーティングラインの企画・設計・開発・販売を展開し、溶剤不使用のコーティング技術の導入支援を行っています。2023年10月に鹿沼事業所に開設した実証実験ラボを積極的に活用しながら、製造工程の中で最もエネルギーを要する設備であるガス熱風乾燥炉を、IHを利用した電気加熱方式であるIH粉体塗装システムに置き換えることによって省エネ、省スペースを実現できる塗装工程ラインをご提案しております。



ラボで事前検証が可能に

新技術に対する顧客の不安を払拭し、スムーズなシステム導入に寄与

### IH粉体塗装技術の活用体制強化

技術・ノウハウを共有

福山事業所  
自社製品の研究・開発

鹿沼事業所(本社)  
実証実験ラボ  
受託製品の研究・開発

北杜事業所  
自社製品の研究・開発

NEW

福山事業所に加え、北杜事業所でもIH粉体塗装システムの導入を進め、実証実験ラボや各事業所で得られた技術・ノウハウを活用して自社製品の開発を進めてまいります。



IH粉体塗装技術で製造した研磨製品



2023年4月より本社を東京オフィスから鹿沼事業所に移転し、本格稼働を開始いたしました。  
今後、計画的に人員・設備・機械の増強を行いながら、更なる生産能力の拡大に努めてまいります。

### 【鹿沼事業所】

敷地面積：約60,000㎡  
延床面積：約46,000㎡

取得日  
2022年4月1日

#### 取得目的

- ・ 受託事業の生産能力拡大
- ・ 事業成長のための場所確保
- ・ BCPの観点から生産体制のリスク分散



受託研磨加工

スリット工程

塗布工程

環境配慮設備

ダイカット工程

物流

### 鹿沼事業所の稼働状況

- ・ 受託塗布・スリットの稼働を開始
- ・ タイ子会社、京都工場からの生産移転
- ・ (株)スガ コーディングスのIH塗装事業の稼働開始
- ・ 東の物流拠点としての機能を集約
- ・ 使用面積増加も可能（未使用エリアは他社へ貸与中）

### 研磨ラボの活用

- ・ 顧客と一体で研磨プロセス、製品開発を進められる体制を構築し、初期ニーズの把握を行い、付加価値が高く迅速な製品提供を展開予定



3つのNEDOプロジェクトに参画しております（うち1プロジェクトはすでに終了）。  
加工技術と評価技術の確立においてさまざまな組織と協力し、国主導のプロジェクトを進めております。

## PROJECT 01

### NEDOグリーンイノベーション基金事業 －次世代デジタルインフラの構築－

オキサイドを幹事会社として（株）UJ-Crystal、国立大学法人東海国立大学機構  
名古屋大学、アイクリスタル株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所が参画

- 前年度は、2年間の委託事業を当初想定通りの成果で終了し、助成期間へ移行。パイロットライン各装置の立上げ、工数削減、シミュレーション技術の構築、及び検査装置の量産化検討を実施した
- 今期は、結晶転位高速検査装置「XS-1 Sirius」において、8インチウェーハ評価対応を開始した（p21参考）

#### 加工技術

##### 大口径SiCウェーハ加工ラインの開発

8インチ対応SiCウェーハ加工、パイロットラインの構築

##### ウェーハ加工工数の削減

加工シミュレーションの検討と削減工程候補の抽出

#### 評価技術

##### 溶液法におけるSiC結晶の評価技術確立

溶液法SiCに適した光学系の最適化とそれに基づく装置設計

##### 大口径ウェーハ観察装置の開発

8インチウェーハに対応した装置使用の検討と設計

## PROJECT 02

### NEDO官民による 若手研究者発掘支援事業

名古屋大学（原田俊太准教授）

- デバイスメーカーとの連携によりデバイス不良との相関を確認し、デバイスキラー欠陥検出もしくはウェーハ品質スクリーニングが可能な量産装置の構築を目指す
- 偏光観察技術の進捗はSiCパワーデバイス製造における品質管理と生産性の向上に貢献しています

#### 評価技術

##### 半導体製造の生産性を向上させる キラー欠陥自動検査システムの開発

[2023年8月論文発表](#)

#### 評価技術

##### パワーデバイスSiCウエハの偏光観察 による結晶欠陥評価技術

[2024年11月論文発表](#) [2025年3月論文発表](#) **NEW**

## 2022年度末 終了

### NEDOマテリアル革新技術 先導研究プログラム

電力中央研究所・名古屋大学（宇治原徹教授）・理化学研究所

- 2022度末に終了し、製品化に向けた開発を継続

#### 評価技術

##### 大型SiC結晶に対する欠陥・ 内部歪の観察解析技術

SiCインゴット検査装置の開発

カーボンニュートラルの実現に向けてエネルギー構造や産業構造の転換、大胆な投資によるイノベーションの創出が必要とされています。これまでの社会の延長にない飛躍的な目標を達成するため創出された、グリーンイノベーション基金のプロジェクトに当社が参画しております。

## 【NEDO※1グリーンイノベーション基金】

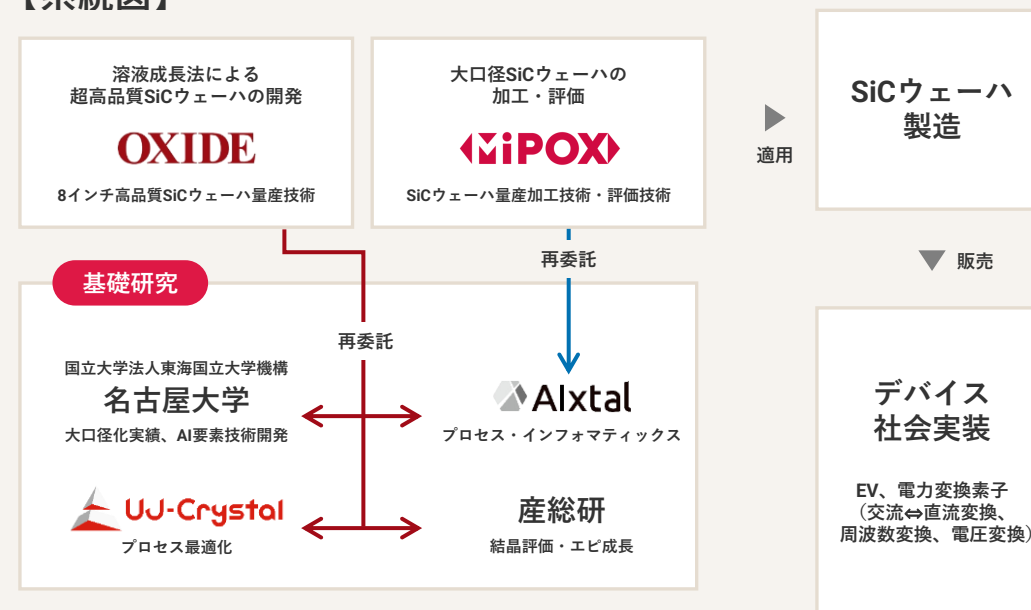
- ・ 日本政府が主導する「2050年カーボンニュートラル」宣言を達成するための基金
- ・ 事業予算2兆円
- ・ カーボンニュートラルに向けた研究開発、実証から社会実装に取り組む企業に最長10年間支援



## 【プロジェクトの目的】

超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発・販売

## 【系統図】



※1：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

# Agenda

---

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期  
第3四半期実績

FY2026 3Q Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

01



代表取締役社長 渡邊 淳 WATANABE Jun

日本とアメリカの大学で学んだ後、1994年当社へ入社。製造現場でキャリアをスタートし、生産技術、国内営業、海外営業を担当後マレーシア駐在員、米国子会社赴任を経験。その後半導体部門長、海外支援部門長に従事。2007年取締役、2008年に先代から引き継ぐ形で現職に就任。就任後は不採算事業撤退や拠点の統廃合を通して赤字からの脱却を行った。業績回復後は製造業として「技術・品質」に加え、デジタルを企業変革の柱と据えてIT推進をリード。

02



取締役 中川 健二 NAKAGAWA Kenji

全自動水洗い洗濯機や半導体CMP後洗浄装置の開発、ハードディスクメディアむけ研磨テープや光学検査装置の技術営業を経験。独立後は光学検査装置のマーケティングから技術、営業や貿易などに携わる。2002年に独立後、2016年当社技術本部長、2019年経営企画部長兼経営管理部長に就任。経営全般に関わりながら、社内組織体制の構築やレフライトのブランディング活動に注力。2021年から新事業開発に携わり、GI基金の大口径SiCウェーハの加工開発を統括している。

03



取締役 上谷 宗久 UETANI Munehisa

2000年に当社入社。台湾支店長や海外子会社の代表取締役を経て、2012年取締役営業本部長に就任。製造拠点の運営、競合他社とのM&A、そして民事再生を経た企業の事業承継等を担当。2017年に退職し、ITベンチャーにおける取締役COOとしての経験をはじめ、エンジニアリング企業での事業開発責任者としての役職を経た後に、2022年4月に当社に復帰。外部活動としてthomas株式会社の社外取締役も務める。

04



社外取締役（独立役員） 加藤 洋美 KATO Hiromi

2007年12月に弁護士登録をし、日比谷法律事務所に入所。以降、法律業務に従事し、2021年4月には同事務所の所長に就任。現在も所長として業務を遂行中。また、2021年4月からは小岩井農牧株式会社の監査役を務めており、2023年4月には株式会社小岩井ファームダイニングの監査役にも就任し、同様に現任している。

05



社外取締役（独立役員） 宮崎 健輔 MIYAZAKI Kensuke

大学卒業後、外資系半導体製品を販売する専門商社に入社し、法人技術営業、全社プロジェクトのリーダー、海外研修、部門立ち上げなどを経験。その後、日本最大のMBAスクールを有する企業グループに転職し、経営大学院にてMBAを取得。法人営業部門のチームリーダー、コンサルタントを務めた。独立後は、経営コンサルタント、エグゼクティブコーチ、組織開発、企業研修などを手がけ、現在も事業・組織領域の両面において幅広く活動を続けている。経営者へのコーチングも行っており、人的資本経営の専門家として、企業の成長支援に注力している。

		経営全般	グローバル 経営	ESG	DX戦略	研究・ 技術開発	M&A	マーケティング・ 営業	製造・ 生産技術	法務・リスク マネジメント	人材戦略
01	 代表取締役社長 渡邊 淳	●	●	●	●		●		●		
02	 取締役 中川 健二					●		●	●		
03	 取締役 上谷 宗久		●		●		●	●			
04	 社外取締役（独立役員） 加藤 洋美									●	
05	 社外取締役（独立役員） 宮崎 健輔			●							●



### 人的資本の充実に向けた取り組みの一環として、従業員のウェルビーイングに関する社内アンケートを実施



#### 目的と位置づけ

- ・ 社員のエンゲージメントや心理的状态を可視化し、離職・休職を未然に防ぐ
- ・ 単なる「負担軽減」ではなく、納得感・共感度の向上を目指す



#### 特徴と現状

- ・ 予防的要素が強く、将来的な向上に重点
- ・ 回答率は9割超と高水準 → 社員の関心度の高さを示す
- ・ ウェルビーイングスコアは5.8/10点（2025年3月末現在）



#### 今後の方針

- ・ 現状は、「数値の意味づけ」と「目標の明確化」に向けた段階
- ・ 現時点では事実ベースで開示し、改善策を検討中
- ・ 将来的に、定点観測と改善サイクルの確立を目指す



アンケート回答率 **90%以上**



当社では、次世代を担う人材の育成と長期的なキャリア形成を重視しています。そのため、以下のような多様な取り組みを行っています。

## 採用や育成に関する取り組み

### 【工場見学及びインターンシップ】

高校生を対象に工場見学やインターンシップを実施し、職業体験を通じて実際の業務を理解してもらう機会を提供しています。これにより、若い世代の興味を引き出し、将来の採用につなげています。

### 【OJT教育と研修制度】

当社の教育プログラムはOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を中心に構成されています。新入社員は現場での実務経験を積むことで、実践的なスキルを身につけます。また、各部署やキャリアパスに応じてフォローアップ研修を行い、継続的な成長を支援しています。具体的な研修内容としては、入社時研修、拠点間研修、ビジネススキル研修（外部研修）などがあります。

### 【新卒定着率】

当社の**新卒定着率※は80.0%**と高く、これは充実した研修制度と働きやすい環境が実現されている証です。新入社員が長期にわたり安心して働けるよう、支援体制を整えています。

※過去5年採用新卒定着率。国内データに基づく。

※2025年3月末現在



**新卒定着率 80.0%**

当社では、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、柔軟で多様な働き方を推進しています。



平均残業時間  
**11～15時間/月**

男性育休取得率 **80.0%**

## 働き方に関する取り組み

### 【在宅勤務とスーパーフレックス制度】

働く場所や時間に柔軟性を持たせることで、従業員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにしています。

### 【ハレアワー制度】

社員がリフレッシュし、仲間との絆を深めるために、時間単位で取得できる休暇制度です。具体的な活動例としては、部や課の全員でプロスポーツの応援に行く、花見や暑気払いを行う、打ち合わせ後に全員でボーリングに行くなどが含まれます。この制度は社員全員がリフレッシュし、良好な人間関係を築くことを目的としています。

### 【地域貢献活動】

小中学生を対象とした「研磨加工教室」の開催や定期的な公園美化活動の実施等を通して、地域社会への貢献を大切にしています。

### 【社内行事】

当社が大切にしている『みんな仲良く』の精神を実現するため、また「働き方改革」の一環として、社内行事を積極的に実施しています。これにより、社員間のコミュニケーションが深まり、より良いチームワークが築かれています。

### 【残業時間の管理】

当社の従業員の**平均残業時間は年間で12.4時間、月11～15時間※**を推移しています。具体的な目標数値は持っていませんが、バランスの取れた働き方を重視しています。

### 【有給休暇取得率】

有給取得率の**目標を80%**と設定しており、現状では**92.1%※**です。これにより、従業員のワークライフバランス向上を図っています。また、**男性育休取得率は80.0%※**となっております。

当社では、従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場環境を実現するために、以下の取り組みを行っています。

### エンゲージメントに関する取り組み

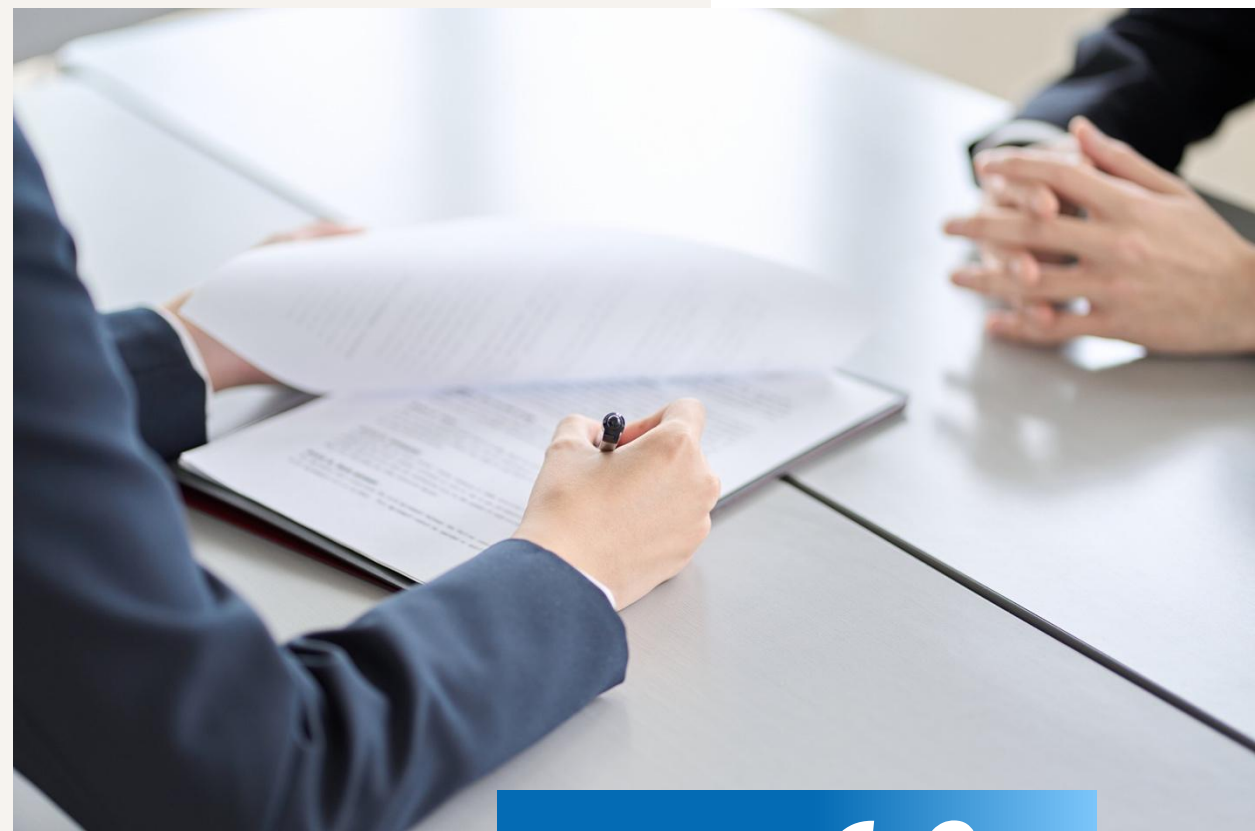
#### 【COMPASSの作成】

当社の指針となる「**COMPASS**」を作成し、全従業員に共有しています。この指針は、企業理念やビジョン、行動指針を明確にし、従業員が日々の業務において共通の目標と価値観を持つための基盤となっています。

#### 【定期的なアンケートの実施】

従業員の声を直接反映させるために、定期的に従業員サーベイ（ウェルビーイングサーベイ）を実施しています。このアンケートでは、従業員の満足度や不満点を収集し、それに基づいた具体的な対策を講じています。従業員の意見を積極的に取り入れることで、働きやすい環境の整備とエンゲージメント向上を図っています。

これらの取り組みの結果として、当社の**退職率は6.9%（グローバル）**となっており、従業員が長く安心して働ける環境が整っています。これからも、従業員の声を大切にし、エンゲージメント向上に努めてまいります。



退職率 **6.9%**



当社では、安全と適正を最優先に考え、職場環境の最適化に向けた取り組みを積極的に行っています。



## 5S活動

### 健康・安全に関する取り組み

#### 【5S活動】

5つの要素からなる5S活動を推進しています。これにより、職場の安全性を向上させ、効率的な作業環境を整えています。

#### 【5Sとは】

- 整理** Seiri : いらないものを捨てる
- 整頓** Seiton : 決められたものを決められた場所に置き、取り出せる状態にしておく
- 清掃** Seisou : 常に掃除する
- 清潔** Seiketsu : 3S（整理、整頓、清掃）を維持し、職場の衛生を保つ
- 躰** Shitsuke : 決められたルールを守る、手順を正しく守る、習慣をつける

当社は生産性向上のための業務効率化を行っています。安全性、快適性の高い工場を目指し、決められたルールを当たり前を守る風土を作り、会社の信用度、会社の利益に繋がります。安全で安心して働ける職場環境の維持と向上に努めています。

当社では、多様性を尊重し、誰もが活躍できる職場環境の実現に向けた取り組みを進めています。

### ダイバーシティに関する取り組み

#### 【男女別従業員比率】

従業員比率は**男性：女性が3.6：1（グローバル）**となっています。これに対して、女性の採用や昇進の機会を増やす取り組みを進めています。

#### 【男女別賃金格差】

**男女間の賃金格差は61.8%（国内のみ）**です。なお、属性（勤続年数、役職等）が同じ男女労働者間での賃金の差異はありません。

#### 【女性管理職比率】

**女性管理職比率は11.4%（グローバル）**です。女性リーダーの育成プログラムやメンター制度を導入し、女性が管理職として活躍できる環境作りを推進しています。

#### 【障がい者雇用比率】

**障がい者雇用比率は1.8%（国内のみ）**であり、目標の2.7%（2026年までに）に向けて取り組んでいます。職場のバリアフリー化や障がい者向けの職務設計を進めることで、働きやすい環境を整備しています。



男女間の賃金格差 **61.8%**

女性管理職比率 **11.4%**

障がい者雇用比率 **1.8%**

## Environment



- ・ 太陽光パネル導入の推進
- ・ IH 粉体塗装システム
- ・ RTOの利用によるVOC削減
- ・ LNGボイラの導入
- ・ リサイクル素材を使用した製品の開発
- ・ グリーンイノベーションへの取り組み
- ・ ISO14001 にもとづいた環境負荷軽減

## Social

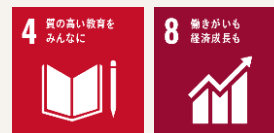


- ・ Eラーニングによる社内教育の充実
- ・ スーパーフレックスタイムの導入
- ・ 人事評価システムの構築
- ・ 資格取得の促進及び取得後の手当の充実
- ・ 労働災害事故の防止
- ・ 若手の定着率の向上
- ・ 女性従業員比率の向上

## Governance

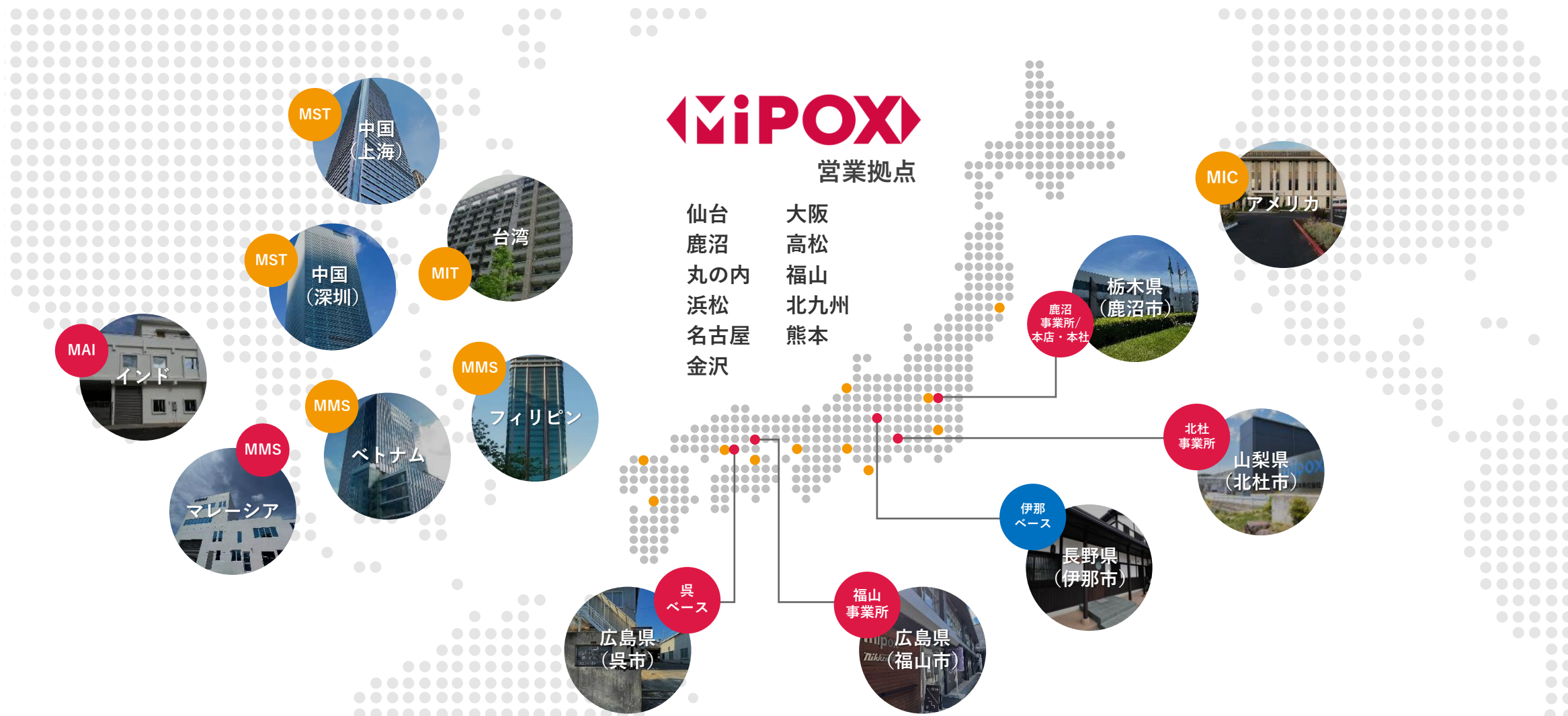


- ・ 透明性のある情報開示
- ・ 内部通報窓口を外部企業に委託
- ・ 全社員に対するコンプライアンス研修の実施
- ・ グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制の強化





● 工場/オフィス ● 営業拠点 ● サテライトラボ



## IRお問い合わせ

フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様へのお問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせはこちら ➤

<https://www.mipox.co.jp/inquiry.html>

